

## 半導体製品梱包開封後の保管のお取り扱いについて

近年の高密度実装された半導体パッケージは、従来の製品よりも開封後の保管条件が厳しく規定されています。そのため、お客様で管理されている条件では不適合となる可能性がございます。

保管条件が不適合の場合、半導体パッケージ内部が過剰に湿気を吸収している状態となっています。過剰な吸湿状態でのリフローは、水分の気化によって生じる膨張が許容値を超えるため深刻なダメージが発生することも予想されます。

このようなケースによる不具合は製品保証の対象外となることから、注意喚起をさせていただきます。

大変恐縮ではございますが、今一度半導体製品に設定されているMSL(Moisture Sensitivity Level)と下記保管条件との適合性についてご確認いただけますようお願いいたします。

MSL	保管期間	保管条件
1	無期限	Ta $\leq$ 30°C 85%RH 以下
2	1 年	Ta $\leq$ 30°C 60%RH 以下
2a	4 週間	同上
3	7 日間	同上
4	72 時間	同上
5	48 時間	同上
5a	24 時間	同上
6	即時	同上

以上